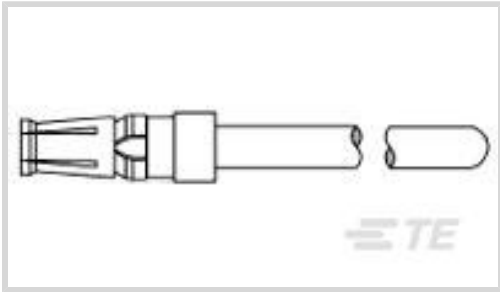




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插座**

D-Sub 端子大小: 8

端子基材: **铜合金**

端子接触部电镀材料: **金**

连接器和端子端接到: **印刷电路板**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	印刷电路板

接触件特性

端子接触部电镀厚度	1.27 μm[50 μin]
端子种类	长
端子底板材料	镍
端子类型	插座
D-Sub 端子大小	8
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	10 A

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
电路应用	Power

包装特性

封装数量	100
------	-----



封装方法	零散零件
其他	
注释	这些接触件只能与标准连接器搭配使用。请勿与盲配连接器一起使用。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20Z25-24SNV001
RECP ASSY



TE 产品编号1757828-4
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,ZN,4



TE 产品编号1757830-4
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,ZN,4



TE 产品编号1757836-4
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,4



TE 产品编号1-1617039-8
HMS1201S004 = 2100 HMS RELAY

TE 产品编号1393139-4
MDR-134-1=MDR

TE 产品编号1623149-1
CRG0805 1% 20K

TE 产品编号1-1617795-0
FCA-150-BY4=Relay

TE 产品编号1617805-4
TD229C-1203TY=TDFR 120 SEC

文档

产品图纸

SOCKET CONTACT ASSY.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_445798-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。